

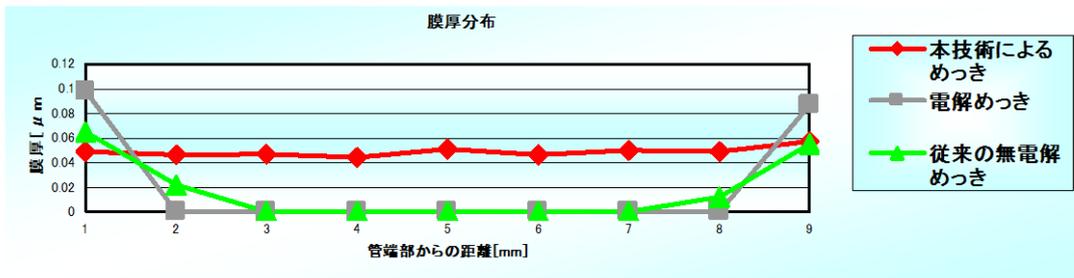
# 光通信用ケーブルで活躍する

# 細管内への無電解めっき

## 1. 技術要旨

近年の電子部品はますます小型化・軽量化の方向に進み、めっき技術の開発はその小型化のスピードに対応できていないのが現状である。特に金属管については、内径の微小化が進み、従来のめっき工法では困難となっている。本技術はめっきの析出が困難な**微細管内部に確実かつ均一にめっきを析出させることが可能である。**

無電解めっきのばらつきについては、発生する水素ガスが管内部に残留することが原因であることを確認した。反応ガスを連続除去してめっきを行った場合、管内部には実用可能範囲でめっきの析出制御が可能となる。



## 2. 製品の特徴 カバーリング

現在までの実績として、内径  $\phi 0.15 \sim 0.50\text{mm}$ 、長さ  $6 \sim 10\text{mm}$  の管内面にめっきを析出させることが可能である。

従来のめっき法では、約  $2\text{mm}$  の深さでめっきの析出が不可能となった。本技術を用いて行った無電解めっきでは、 $10\text{mm}$  の管内全面にめっき析出が見られる。

## 3. 応用製品 光通信用ケーブル・プローブ等に使用されるパイプ状微細部品

めっき後管内断面写真

図 1. 電解金めっき

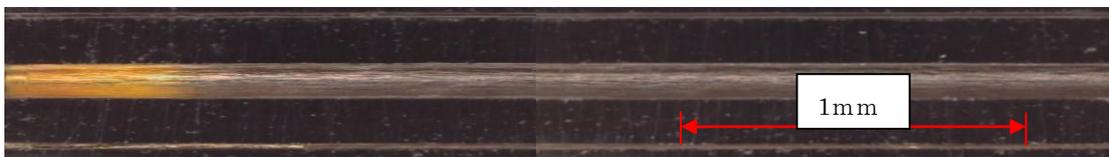


図 2. 従来の無電解金めっき



図 3. 本技術による無電解金めっき



株式会社 友電舎

大阪市此花区常吉 2-4-8

Tel : 06-6465-1663 fax : 06-6468-5600

e-mail : [info@ydn.co.jp](mailto:info@ydn.co.jp) (代表)

URL : <http://www.ydn.co.jp>